



美光與 Intel 宣佈 3D XPoint™ 共同開發計畫新進展

美國愛達荷州博伊西市和加州聖塔克拉拉 (2018 年 7 月 16 日) – 美光科技公司 (NASDAQ 股票代碼 : MU) 和 Intel 今日宣佈了他們在 3D XPoint™ 合作開發計畫的最新進展，推出一個比 NAND 記憶體具備更低延遲時間且耐用性大幅增加的全新非揮發性記憶體。

兩家公司已同意第二代 3D XPoint 技術開發的共同合作，預計將於 2019 上半年完成。第二代 3D XPoint 技術之後更先進的技術開發將由兩家公司各自進行，以發展出最佳的技術，應因自家產品和業務的需求。

兩家公司將在猶他州李海 (Lehi) 的 Intel-Micron Flash Technologies 廠 (簡稱 “IMFT”) 繼續以 3D XPoint 技術製造相關記憶體產品。

美光技術開發執行副總裁 Scott DeBoer 表示：「美光在記憶體發展上擁有 40 年的研發創新專業地位，我們將繼續推動發展下一代 3D XPoint 技術。我們對能應用此一先進技術所開發的產品感到相當興奮，這技術將有助於我們的客戶享有獨特的記憶體和儲存性能優勢。透過獨立開發 3D XPoint 技術，美光得以為自家的產品規劃藍圖，開發出更優異的技術，並兼顧客戶和股東的最大利益。」

Intel 非揮發性記憶體解決方案事業群資深副總裁暨總經理 Rob Crooke 表示：「由於我們客戶提供顧客和資料中心市場的支援，Intel 已推出廣泛的 Optane 產品組合，並取得領導性的地位。Intel Optane 與全球最先進運算平台的直接連結在 IT 和消費應用方面已有突破性的成果。我們計劃延續這個發展動能，結合高密度 3D NAND 技術，擴大在 Optane 的領先地位，為現今的運算和儲存需求提供最佳解決方案。」

關於 Micron (簡稱 “美光”)

美光為創新記憶體和儲存解決方案的領導廠商。美光的全球品牌 Micron®、Crucial® 和 Ballistix® 擁有廣泛的高性能記憶體和儲存技術產品組合，其中包括 DRAM、NAND、NOR Flash 和 3D XPoint™ 記憶體。它們都正在改變世界使用資訊的方式，使人們的生活更豐富。以將近 40 年的技術領導地位為後盾，美光的記憶體和儲存解決方案可支援在雲端運算、數據中心、網路和行動裝置等關鍵市場領域具顛覆性的最新趨勢，包括人工智慧、機器學習和自動駕駛。美光的普通股在 NASDAQ 上市交易，其股票代碼為 MU。欲知更多美光相關資訊，請至 www.micron.com。

關於 Intel

Intel (NASDAQ:INTC) 突破技術障礙，為新創產品體驗帶來新氣象。有關 Intel 的資訊，請參閱 newsroom.intel.com 及 intel.com。

美光媒體關係聯絡人

David Oro

Micron Technology, Inc.

+1 (707) 558-8585

davidoro@micron.com

Intel 媒體關係聯絡人

Daniel Francisco

Intel

+1 (916) 812-8814

daniel.francisco@intel.com

美光投資人關係聯絡人

Shanye Hudson

Micron Technology, Inc.

+1 (208) 492-1205

shudson@micron.com

Intel 投資人關係聯絡人

Mark Henninger

Intel

+1 (408) 653-9944

mark.h.henninger@intel.com

###

©2018 Micron Technology, Inc. 版權所有。資訊、產品及 / 或規格若有修改，恕不另行通知。所有資料提供係根據「現狀」處理，不提供任何形式的擔保。附圖可能未按比例繪製。Micron、Micron 標誌及所有其它 Micron 商標為 Micron Technology, Inc. 的資產。所有其他商標則為其個別持有人之財產。